Raise3D DF2 - Technická specifikace

Jádrem řešení Raise3D DF2 je systém digitálního světelného tisku (DLP), který zaručuje rychlost, kvalitu, výjimečnou spolehlivost a produktivitu díky RFID. 3D tiskárna DF2 je určena pro výrobu konstrukčních prototypů, výrobních pomůcek a malosériovou výrobu s využitím široké škály technických materiálů / pryskyřic.

Tiskárna	Raise3D DF2	
Hardware	Technologie tisku	Digital Light Printing (DLP)
	Stavební komora (š × h × v)	200 × 112 × 300 mm
	Rozlišení XY	2560 × 1440
	Max hmotnost modelu	10 kg
	Max rychlost tisku	25 mm/h (při vrstvě 0,1)
	Výška vrstvy	0,05 - 0,10 mm
	Správa resinu	Automatické dávkování, hlídání hladiny, rozpoznání typu resinu díky RFID
	Ovládání	Velký dotykový panel (rozlišení 1920 x 720) s mnoha funkcemi obsluhy včetně přímého rozvržení tisků nebo duplikace výtisků
	čip RFID tiskové desky	Uchovává informaci typu resinu pro automatická nastavení tisku, oplachu a UV vytvrzení
	Kalibrace tiskové desky	Předkalibrováno z výroby
	Vyhřívání komory	Max 40°C
Pryskyřice (Resiny)	Resiny Raise3D	Raise3D Standard White Resin, Raise3D High Detail Apricot Resin, Raise3D Tough 2K Grey Resin, Raise3D Rigid 3K Grey Resin, Raise3D High Clear Resin (Coming soon), Raise3D High Temperature Resin (Coming soon)
	Co-branding Resiny od výrobců BASF a Henkel	LOCTITE 3D IND405™, LOCTITE 3D PRO476™, Ultracur3D® RG 3280, Ultracur3D® RG 1100 B
	ORP (Open Resin Program)	Coming soon
Software and Network	Konektivita	Wi-Fi, LAN, USB port × 2, Live Camera
	Síťový standard	Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n
	Slicovací Software	ideaMaker (Features: Antialiasing; Auto Support; Auto Orientation; Auto Cross Section Analysis; Contour Compensation; Suction Cup Detection; Hollow; Drainage Hole; Texture Generation; Smaller Gcode Size)
	Vzdálená management	RaiseCloud (Coming soon)
	Podporované typy souborů	STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP
	Podporované OS	WINDOWS/ macOS/ LINUX
Operation and Shipping	Napájení	100-240 V AC, 50/60 Hz 230 V @ 3.3 A
	Teplota provozního prostředí	15 - 30°C, 10 - 90% RH Non-Condensing (HOLD)
	Teplota skladování	-25 to 55°C, 10 - 90% RH Non-Condensing (HOLD)
	Velikost zařízení (š × h × v)	450 × 400 × 730 mm
	Hmotnost zařízení	40 kg
	Přepravní hmotnost zařízení	59.4 kg
	Přepravní rozměry	710 × 595 × 980 mm

www.raise3d.com

© 2024 by Raise3D. Všechna práva vyhrazena včetně úpravy specifikace bez předchozího upozornění

ELVIRA ABC3D RAISE3D

Raise3D DF Wash & DF Cure - Technická specifikace

Jádrem řešení Raise3D DF2 je systém digitálního světelného tisku (DLP), který zaručuje rychlost, kvalitu, výjimečnou spolehlivost a produktivitu díky RFID. 3D tiskárna DF2 je určena pro výrobu konstrukčních prototypů, výrobních pomůcek a malosériovou výrobu s využitím široké škály technických materiálů / pryskyřic.

Oplach	Raise3D DF Wash	
Hardware	Objem tanku oplachu	14 L
	Max. velikost výtisku oplachu	200 × 112 × 300 mm
	Kompatibilní roztoky oplachu	IPA, TPM, voda
	Charakteristika sušení	Turbo-dvojitý oplach, simulace ručního oplachu
	Sušení při oplachu	Dvojité ventilátorové vysušení
	Vypuštění kapaliny oplachu	Automatické vypouštění kapaliny s nádobou na odpad
	Profil oplachu	RFID Automatické nastavení bez zásahu operátora
Provozní a dodací parametry	Napájení	100-240 V AC, 50/60 Hz, 96 W
	Provozní teplota	10°C-35°C
	Skladovací teplota	-25 až 55°C, 10 - 90% RV nekondenzující
	Hmotnost zařízení	27.7 kg
	Přepravní hmotnost zařízení	45.8 kg
	Hmotnost kanystru	0.7 kg
	Přepravní hmotnost kanystru	1.5 kg
	Velikost zařízení (š × h × v)	400 × 410 × 646 mm
	Velikost kanystru (š × h × v)	350 × 190 × 290 mm
	Přepravní velikost zařízení	725 × 585 × 915 mm
	Přepravní velikost kanystru	407 × 247 × 349 mm

UV vytvrzení	Raise3D DF Cure	
Hardware	Max velikost modelu	Ø 230 x 300 mm
	Zdroj světla	LED (365nm, 385nm, 405nm mix); Max teplota v komoře během osvitu do 120°C
	Profily osvitu	RFID Automaticky přednastavené nebo ruční nastavení
Provozní a dodací parametry	Napájení	100-240 V AC, 50/60 Hz, 500 W
	Provozní teplota	10-35°C
	Skladovací teplota	-25 až 55°C, 10 - 90% RV nekondenzující
	Hmotnost zařízení	32.8 kg (72.3 lbs)
	Přepravní hmotnost zařízení	49.2 kg (108.5 lbs)
	Velikost zařízení (š × h × v)	490 × 400 × 610 mm
	Přepravní velikost zařízení (š × h × v)	725 × 585 × 850 mm

© 2024 by Raise3D. Všechna práva vyhrazena včetně úpravy specifikace bez předchozího upozornění